

GreTai Securities Market and BNP Paribas

Taiwan Corporate Access Day

執行副總 張季明 博士

May 12-15, 2008

Innovative Testing

Ardentec

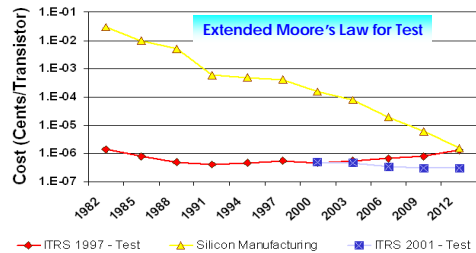
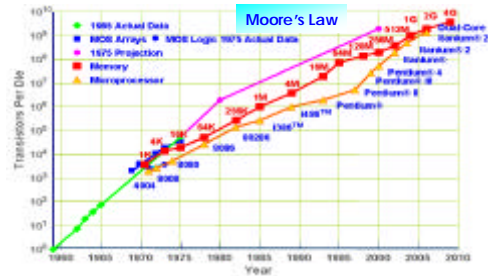
經營理念

■ 公司願景

成為IC產業朝摩爾定律前進之
關鍵測試技術推動者

■ 公司目標

成為半導體產品驗證、測試量
產之最具成本/效益的專業領導
廠商

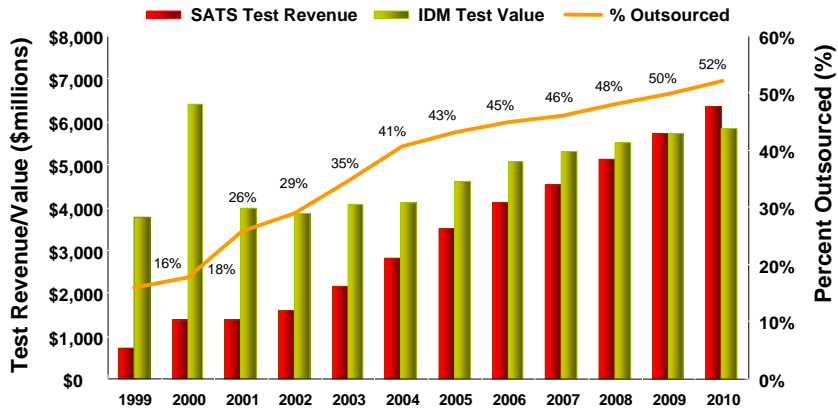


Innovative Testing

Ardentec

全球測試市場

委外趨勢持續上升!



Source: Gartner Dataquest (May 2006, Jan 2006, Jan 2003)
VLSI Research (Jan 2000)

2

Innovative Testing

Ardentec

系統封裝/裸晶測試技術的領先廠商

追求摩爾定律，系統封裝正是趨勢

- 在趨向高度整合、SiP測試需求、異質多功能整合的無線元件市場，KGD (Known-Good-Die) 測試的需求與重要性日益增加。
- KGD 測試是目前主要的解決方案，因為沒有其他方式可以滿足在SiP形式下所有的測試需要。

欣銓在KGD測試技術的貢獻

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 可靠性及品質篩選流程 <ul style="list-style-type: none"> - 晶圓級預燒 - 應用統計技術的品質篩選程序(outlier process) 以及特定樣式異常的篩選 ■ 良率改善製程 <ul style="list-style-type: none"> - 雷射修補 - 類比信號微調 - 註記編碼 ■ 高整合測試流程 <ul style="list-style-type: none"> - 作業管制自動化IT系統 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 節省成本方案 <ul style="list-style-type: none"> - 高並測數 ■ 高速測試 <ul style="list-style-type: none"> - 可測試設計之結構測試 ■ 低功率及 & 行動性 <ul style="list-style-type: none"> - 低溫及漏電流測試 ■ 晶圓製程線距微縮 <ul style="list-style-type: none"> - 12吋晶圓針測 - 錫墊微距產品 (Fine Pad Pitch) 針測 - 微距融絲 (Fine Link Pitch) 雷射修補 - Low-k 銅製程錫墊針測 |
|---|---|

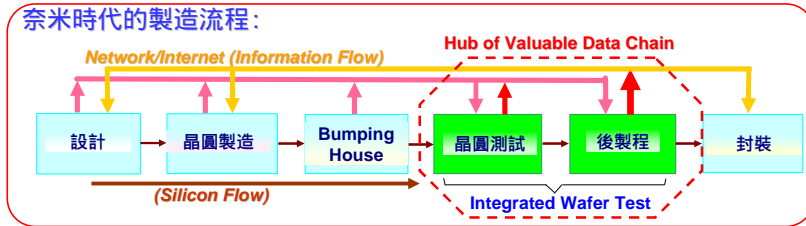
3

Innovative Testing

Ardentec

在新興的價值鏈上扮演處理中心的角色

- 進入奈米時代，欣銓在後段流程中建立一個 ” 後製程 ” (Post-Process)
- 整合設計、製造、測試之所有數據，用以篩選 IC
- 經由資訊高速公路，提供最廣泛的測試數據
- 在有價值的數據鏈上扮演 “ 處理中心 ” 的角色



4

Innovative Testing

Ardentec

競爭優勢

- 與客戶群中的晶圓製造工程師、產品測試工程師及產品設計工程師有相同的語言
- 欣銓的品質系統能夠迅速處理大量的測試資訊，滿足客戶的質與量之需求
- 欣銓透過建置好的WIP/EDAS等IT系統，能夠提供即時且透明的訊息回饋
- 欣銓擁有服務國際級一流大廠的經驗
- 欣銓擁有臺灣最大的12吋晶圓測試產線，足以服務世界級的客戶
- 欣銓在新加坡已建置好營運中心能夠提供客戶群更寬廣及彈性的服務

5

Innovative Testing

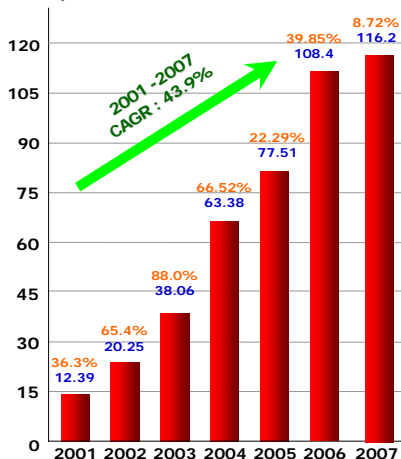
Ardentec

營收成長

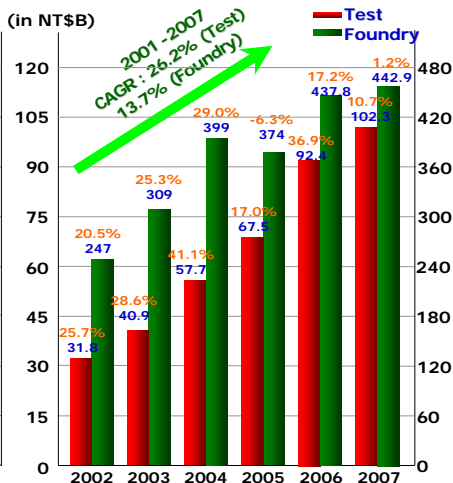
欣銓科技

臺灣半導體產業

(in US\$M)



(in NT\$B)



Data Source: IEK 2008 Feb. 6

Innovative Testing

Ardentec

良好的財務比率 (臺灣)

年度	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
流動性比率							
流動比率	138%	172%	173%	226%	177%	218%	201%
速動比率	134%	165%	168%	215%	167%	206%	195%
資產管理比率							
固定資產週轉率	0.19	0.26	0.43	0.60	0.57	0.68	0.65
總資產週轉率	0.14	0.21	0.33	0.43	0.40	0.46	0.42
負債管理比率							
負債比率	41.2%	51.0%	46.5%	31.3%	35.9%	29.6%	31.6%
利息保障倍數	-	0.34	3.90	10.08	14.30	19.19	15.96
獲利性比率							
毛利率	-24.2%	10.7%	33.1%	45.3%	40.9%	42.2%	39.0%
總資產報酬率	-5.9%	2.7%	11.4%	17.3%	13.7%	15.0%	12.3%
股東權益報酬率	-11.0%	0.3%	17.6%	25.2%	19.3%	21.1%	16.6%
每股盈餘	-1.06	0.03	1.78	3.00	2.62	3.05	2.62

7

Innovative Testing

Ardentec

損益表相關重要比率 (臺灣)

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

年度	1Q'06	2Q'06	3Q'06	4Q'06	1Q'07	2Q'07	3Q'07	4Q'07	1Q'08
營收	821,109	920,294	902,770	882,354	731,347	831,513	1,048,679	1,039,833	1,049,058
較前季營收成長(%)	(1%)	12%	(2%)	(2%)	(17%)	14%	26%	(1%)	1%
毛利	365,311	409,752	382,096	329,951	178,636	290,819	478,780	474,602	471,363
毛利率(%)	44%	45%	42%	37%	24%	35%	46%	46%	45%
營業淨利	326,370	359,969	337,603	281,083	132,458	243,366	424,937	410,282	387,103
營業淨利率(%)	40%	39%	37%	32%	18%	29%	41%	39%	37%
稅後淨利	253,114	316,418	281,155	234,601	112,491	197,510	341,234	348,885	320,232
稅後淨利率(%)	31%	34%	31%	27%	15%	24%	33%	34%	31%
每股盈餘	0.81	0.97	0.63	0.64	0.31	0.52	0.88	0.91	0.83

8

Innovative Testing

Ardentec

近期大事記

- 2005年1月欣銓科技股票於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易
- 2006年4月獲頒美商德州儀器2005年「優良供應商獎」
- 2006年4月完成新台幣20億元的聯貸案簽約
- 2006年6月成立新加坡子公司Ardentec Singapore Pte. Ltd.
- 2006年10月與台北關稅局簽訂策略聯盟
- 2007年8月類比IC的晶圓測試服務開始量產
- 2008年1月榮獲SanDisk 2007年傑出合作夥伴的榮譽
- 2008年2月通過ISO27001認證

9

Innovative Testing

Ardentec

新加坡子公司

- 建立新加坡的測試服務據點
- 成功的移轉複製先進技術的測試生產系統
- 2007年1月通過第一家客戶的認證
- 2007年6月通過ISO9001認證
- 2007年7月第二家IDM客戶開始量產
- 2008年1月開始與當地晶圓代工廠展開合作2個新測試平台的生產線
- 2007年1月開始量產，至2008年1月單月測試12吋晶圓已達萬片
- 持續擴產在當地的市場